

**Zeitschrift:** Schweizer Ingenieur und Architekt  
**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  
**Band:** 106 (1988)  
**Heft:** 12

## Sonstiges

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 22.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Aus Technik und Wirtschaft

### IBM SNA/SDLC im Ethernet Wide Area Network

Die Firma Teleinform AG, Bubikon bietet mit TransSDLC eine Erweiterung der 802 WAN TM Familie von Vitalink an.

TransSDLC integriert IBM FEP und Cluster Controller in bestehende Netzwerke wie z. B. Ethernet und benutzt diese Netzwerke als Übermittlungsmedium. Daten können am gleichen oder einem remote LAN via TransLAN-Bridge ausgetauscht werden. TransSDLC übermittelt kein Polling. IDLE-Pakete werden ebenfalls unterdrückt. Dieses Gerät ersetzt keine FEP oder Cluster Controller sondern integriert diese in bestehende Netzwerke. Bei Netzwerkänderungen muss nur das TransSDLC neu konfiguriert werden. Mit TransSDLC können FEP-Ports eingespart werden. Eine 56 Kbps FEP - TransSDLC Verbindung kann z. B. für 5 Cluster Controller konfiguriert werden. Auf der Remote-Seite können die 5 Cluster Controller mit verschiedenen Geschwindigkeiten, point to point oder multipoint angeschlossen werden.

Die meisten Parameter in TransSDLC werden On-line konfiguriert um Betriebsunterbrechungen klein zu halten. TransSDLC hat eine Konfigurationstabelle für maximal 32 SDLC PU2 und unterstützt Kanalgeschwindigkeiten bis zu 64 Kbps mit RS 232/V.35 Schnittstellen.

Umfassende Statistiken über

Verzögerungszeiten, Laufzeiten der Pakete, Linkauslastung, etc. können an der Konsole abgerufen werden.

TransSDLC arbeitet als «Host Interface Processor» (HIP) oder «Cluster Interface Processor» (CIP). Die SNA FEP/Host erkennen einen HIP als eine oder mehrere sekundäre SDLC Station SNA 3270 Cluster. Ein HIP beantwortet Host-Polling und Daten sofort und garantiert die Datenübermittlung. Ein HIP deaktiviert idle HIP zu CIP Verbindungen ohne LU - LU Verbindungen zu unterbrechen.

SDLC Cluster Controller erkennen einen CIP als einen IBM SNA 3725 FEP. Ein CIP emuliert das FEP Polling lokal und beantwortet Daten sofort. PU4 zu PU2 Verbindungen.

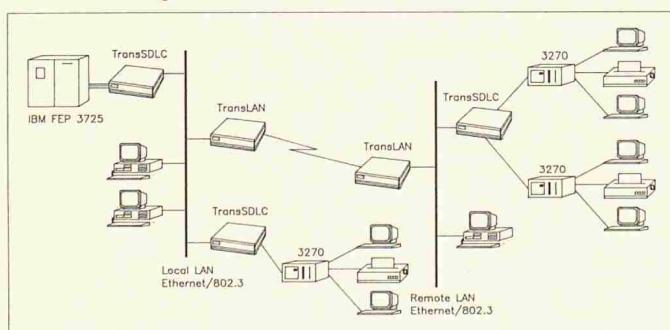
Bei einer TransSDLC Installation erübrigt sich meistens eine SYSGEN-Änderung der SNA FEP/Host Software und Hardware.

Typische Anwendung: Anstelle von Parallel-Führung von IBM und Ethernet Verkabelungen, Einsatz des TransSDLC zur gleichzeitigen Übermittlung von IBM Daten über das 10 Mbps Ethernet-Kabel.

TransSDLC besitzt die gleiche Software Management wie TransLAN, TransLINK und TransRING.

Teleinform AG  
8608 Bubikon

### TransSDLC Konfiguration



### Neues «Kleb- und Dichtungswunder»

Auf jeder Baustelle gibt es immer etwas abzudichten, anzukleben oder zu reparieren! Speziell für diese Art von Arbeiten wurde die elastische, preisgünstige und praktisch universell einsetzbare Kleb- und Dichtungsmasse Tegucol 310 entwickelt. Tegucol 310 ist eine Masse

auf der Basis von modifiziertem Spezialbitumen und ist prädestiniert für folgende Einsatzbereiche: Als *Haftmittel* für bituminöse Dachdeckungen, als *Dichtungsmasse* für Risse und Fugen, zum *Kaltverkleben* der Stössel bei Bitumenunterdächern (z.B. Tegubit), als *Reparaturmasse* bei

undichten Rinnen, als *Abdichtungsmasse* bei Kamin- und Fensterabschlüssen usw.

Tegucol 310 haftet hervorragend auf Beton, Stein, Asbestzement, Pappe, Glas, Tegubit, Holz etc. Sogar auf feuchten Untergründen ist eine hohe Kleb- und Haftkraft gewährleistet. Tegucol 310 ist in Kartuschen à 310 ml

erhältlich, und das Produkt wird mittels einer handelsüblichen Kittpistole verarbeitet.

Tegucol 310 wurde von Fachleuten für Fachleute entwickelt und gehört auf jede Baustelle!

Tegum AG  
Leutschenbachstr. 45  
8052 Zürich

### Neu von Sigma Coatings

Sigma Coatings ist die erste Firma auf dem Markt mit Pulverbeschichtungen auf Kynar PVDF-Basis für dauerhaftere Außenflächen von Bauwerken. Das holländische Unternehmen Sigma Coatings B. V., Hersteller von Schutzbeschichtungen für Bauwerke, hat ein neues Pulverbeschichtungssystem für Aluminiumprofile und Verkleidungen entwickelt. Es basiert auf dem bereits durch seine hohe Beständigkeit bei der Beschichtung von Bauten bekannten Kynar PVDF (Polyvinylidenfluorid) von Pennwalt. Diese Lacke auf Fluorid-Polymer-Basis wurden bisher als Nassspray aufgetragen. Sigma hat es jetzt möglich gemacht, PVDF als Pulverbeschichtung aufzutragen und bringt es als erste Firma in den Handel.

Das System wurde auf Anregungen von Architekten und verarbeitenden Betrieben entwickelt. Verarbeitende Betriebe fordern ein wirksameres, emissionsfreies Verfahren für PVDF-Spraybeschichtung. Und Architekten und Designer verlangen ein besseres Qualitätsprodukt als Polyester-Pulverbeschichtungssysteme. Sigma hat für beide Probleme eine Lösung - PVDF-Pulver.

Das neue Pulverbeschichtungssystem auf PVDF-Basis hat alle Vorteile eines Hochleistungs-PVDF-Nassspraysystems, jedoch mit verbesserten mechanischen Eigenschaften: ein einmäigiger Auftrag sorgt für eine dicke Schutzschicht. Verglichen mit Polyester-Pulver bedeutet es: ausgezeichnete Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit, chemische Beständigkeit und geringe Wartung. Die neue Pulverbeschichtung auf PVDF-Basis ist hinsichtlich Flexibilität, Kratz- und Schlagbeständigkeit besser als Nass-Systeme. Eine Lage PVDF-Pulver von Sigma ist dicker als zwei oder drei Lagen PVDF-Nassspray. Ein Bauwerk wird gleichermassen mit einem Hochleistungs-Kunststoff-Schutzfilm versehen.

Auf Lack- und Glanzbeständigkeit, Lichtheit, Kreiden, Adhäsion und Korrosion wird 10 Jahre Garantie geleistet, wenn die Pulverbeschichtung auf PVDF-Basis von einem von Sigma autorisierten Verarbeitungsbetrieb nach den Sigma-Qualitätsnormen aufgetragen wird.

Sigma Coatings BV  
NL-3700 AC Zeist

### Neue Broschüre: Die Industrieverkabelung

Viele nützliche Tips und Anregungen für die Praxis: Heutzutage werden immer mehr Kommunikations- und Energiekabel in Industriebetrieben, Grosskraftwerken und ähnlichen Objekten zusätzlich oder neu verlegt. Marktuntersuchungen haben gezeigt, dass diese Verkabelungen sehr personal- und damit kostenintensiv sind.

Zeitgemäss Methoden der Industrieverkabelung finden deshalb immer grössere Bedeutung. Rationelle Arbeitstechniken er-

leichtern nicht nur die Verlegung, sondern machen diese vor allem kostengünstiger.

Lancier-Know-how und nützliche Anregungen aus der Praxis waren Anlass für die Herausgabe der Broschüre «Die Industrieverkabelung» mit vielen Tips, praktischen Hinweisen und informativen Abbildungen. Interessenten erhalten diese Informationsbroschüre kostenlos.

Lancier  
Maschinenbau-Hafenhütte  
Postfach 47 01 60  
D-4400 Münster-Wolbeck

## Miniaturisierung im Submikronbereich



PresseFotoDienst Leybold AG

Miniaturisierung ist das Schlagwort und der Trend in der Mikroelektronik. Die Strukturen auf den Waferscheiben - aus denen später die Chips hergestellt werden - haben inzwischen Größenordnungen des Submikronbereiches erreicht. D. h. sie sind kleiner als eintausendstel und bis zu einhunderttausendstel Millimeter klein. Zum Herstellen solcher Strukturen werden chemische Ätzprozesse un-

ter Vakuum eingesetzt. Die gezeigte Dreikammer-Wafer-Plasma-Ätzanlage arbeitet mit TRI-VAC BCS-Drehtriebelpumpen und RUVAC-Wälzkolbenpumpen der Leybold AG. Da beim Ätzen äußerst aggressive Gase benutzt werden, müssen die ölgedichteten Vakuumpumpen extremen Belastungen standhalten.

Leybold AG, Köln

Mai 1988 die Würde eines Ehrendoktors der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne verliehen.

Prof. Fisher zu Ehren veranstaltet das ICOM-Construction métallique der ETH-Lausanne am Mittwoch, den 4. Mai 1988 einen Stahlbautag unter dem Motto: «Forschung im Dienste der Praxis».

Vorträge werden halten die HH. Professoren J. Brozzetti (ENPC, Paris), A. W. Pense (Lehigh), J. W. Fisher (Lehigh), sowie fünf Redner aus dem Kreise der ETH-L.

*Auskünfte, Programme und Anmeldungen:* Sekretariat ICOM-Construction métallique, EPFL, GC-Ecublens, 1015 Lausanne. Tel. 021/47 24 22. Anmeldefrist bis am 15. April 88.

## High Tech in Österreich

Das 3. Kolloquium der IHB-Stiftung (International High-Tech-Forum Basel) findet am 28./29. April 1988 in Wien statt. Tagungsort ist das Technische Zentrum Creditanstalt-Bankverein, Julius Tandler-Platz, 1090 Wien. An der Organisation mitbeteiligt sind das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, das Österreichische Forschungszentrum Seibersdorf, die Vereinigung Österreichischer Industrieller, die technova Graz. Das Tagungsthema «High

Tech in Österreich» wird an Entwicklungsbeispielen aus den Regionen Wien und Graz abgehandelt, wobei die in den Referaten vermittelten Hintergrundinformationen durch Diskussionen und Besichtigungen von Firmen und Forschungsinstituten vertieft werden. Das Detailprogramm ist über folgende Kontaktadresse erhältlich: International High-Tech-Forum Basel, Frau R. Bruns-Marty, c/o Schweizer Mustermesse, Postfach, 4021 Basel.

## Weiterbildung

### Wissenschaft und Praxis: Bauseminar

### Oberflächenschutz von Stahlbeton

mit flexiblen Dichtungsschlämmen im konstruktiven Ingenieurbau

Ein Weiterbildungsseminar der Bauakademie Biberach/D., in Lindau am 15. April 1988.

Seminarleitung: Prof. Dipl.-Ing. Ch. Roller, Rektor der Fachhochschule Biberach, Prof. Dr.

R. Springenschmid, TU München  
Teilnehmergebühr DM 194.-  
Anfragen, Anmeldungen: Bauakademie Biberach, Postfach 1260, D-7950 Biberach (Riss) 1, Tel. (0 73 51) 5 82-18.

## Bauherr und Haustechnik

Veranstaltung im Rahmen des Impulsprogramms Haustechnik in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Hauseigentümerverband Zürich, 4. Mai 1988, im ETH-Zentrum

**Teilnehmerkreis:** Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Bauherren, die wiederholt Dienstleistungen der Haustechnikbranchen (Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär, Elektro) für Neubauten, Sanierungen oder den Betrieb ihrer Liegenschaften in Anspruch nehmen. Auch Architekten in ihrer Funktion als Bauherrenvertreter und Koordinatoren des Planungs- und Bauablaufs sind angesprochen.

**Inhalt:** Die Qualität einer haustechnischen Anlage äußert sich nicht nur in der Höhe der Investitionen und im gelieferten Komfort, sondern auch in der

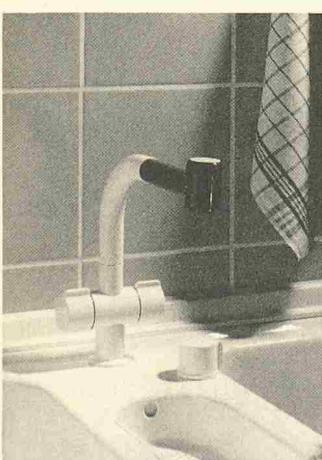
Zuverlässigkeit und den Betriebskosten. Die Veranstaltung will dem Teilnehmer zeigen, welche Hindernisse sich dieser Qualität von der Idee bis zum Betrieb entgegenstellen und wie er bei der Auswahl seiner Fachleute, beim Formulieren der Ziele und Randbedingungen, im Werkvertrag, bei der Abnahme und während des Betriebs diese Hindernisse aus dem Weg räumen kann.

Weitere Auskünfte und Anmeldeunterlagen: Koordination der Fachverbände IPHT, Postfach 65, 8117 Fällanden, Tel. 01/825 08 12 (R. Aeberli).

## SPRINT Küchenarmatur mit Auszugsbrause

Jetzt gibt es SPRINT, die erste Küchenarmatur im modernen High-Tech-Design mit Auszugsbrause.

Die SPRINT Küchenbatterie, welche bereits mit mehreren Designpreisen ausgezeichnet wurde und zweifellos ein Blickfang



in jeder Küche ist, verfügt über eine praktische Auszugsbrause mit verstellbarem Wasserstrahl (Soft- und Regenstrahl), der jedem Anspruch gerecht wird.

Im technischen Bereich lässt die SPRINT Armatur (S 1040) ebenfalls keine Wünsche offen. Dank der modernen Keramik-scheibentechnik lässt sich mit einer Griffdrehung von 180° sowohl Wassermenge wie Temperatur aufs feinste regulieren; auch das lästige Tropfen wegen abgenutzten Gummidichtungen ist bei der SPRINT Küchenbatterie nicht mehr möglich.

Die SPRINT Armaturen sind in allen gängigen Sanitärfarben beim Sanitär-Installateur oder beim Sanitär-Grosshandel erhältlich.

**Metallgiesserei & Armaturenfabrik Lyss**  
Zeughausstrasse 17, 3250 Lyss  
Tel. 032/84 34 64

## Tagungen

### «Forschung im Dienste der Praxis»

#### Stahlbautag zu Ehren Professors John W. Fisher

Professor Dr. John W. Fisher, der an der Universität Lehigh, Bethlehem, USA, Bauingenieurwissenschaften lehrt, wird am 3.